



Medienmitteilung

SY&SE gewinnt den Grossen Ausstellerpreis 2018

Das Start-up aus La Chaux-de-Fonds erregt mit einer revolutionären Verbundtechnologie Aufsehen. Mit ihr lassen sich Werkstoffe ohne Klebstoff oder Lötstellen verbinden.

Genf, 12. Juni 2018 – Vor sieben Jahren wurde der Grosse Ausstellerpreis ins Leben gerufen, mit dem jedes Jahr das innovativste Projekt am Salon EPHJ-EPMT-SMT ausgezeichnet wird. Dieses Jahr gingen bei der Expertenjury, der Eric Rosset, Pierre Amstutz, André Colard, Olivier Saenger und Alexandre Catton angehörten, sehr viele Bewerbungsdossiers ein.

Die Jury nominierte die folgenden sechs Kandidaten für die Endauswahl: Axxios Technology SA, Optec Laser Systems, Vulkam, Cristaltech, Acquandas und SY&SE. Kurz vor der Eröffnung des Salons stimmten die Aussteller über diese sechs Projekte ab.

Die in La Chaux-de-Fonds (NE, Schweiz) ansässige Firma SY&SE erhielt die meisten Stimmen, weshalb ihr am 12. Juni 2018, am Eröffnungsabend des Salon EPHJ-EPMT-SMT, der Grosse Ausstellerpreis verliehen wurde. SY&SE ist ein Start-up der Haute Ecole Arc Ingénierie, das auf Verbindungen von Glas und Keramik mit Metall spezialisiert ist.

Die junge Firma hat eine neue Technologie entwickelt: das von der anodischen Bindung abgeleitete «Impulse Current Bonding» (ICB). Anhand dieser Technologie lassen sich Materialien mit sehr unterschiedlichen Dilatationskoeffizienten klebstofffrei und bei niedriger Temperatur verbinden. Anders als beim Kleben oder Hochtemperaturlöten bleiben die Werkstoffe dabei unversehrt. Ausserdem sind die Verbindungen äusserst belastbar und weisen eine herausragende Dichtigkeit auf.

Von dieser auf alle Arten von Werkstoffen anwendbaren Technologie können zahlreiche Industriesektoren profitieren, namentlich die Uhren- und die Medizintechnikbranche.

Kontaktstelle SY&SE: Sébastien Brun, Gründer, s.brun@syandse.ch, Tel.: +41 76 675 36 00

Medienkontakt: Stephan Post, spo@dynamicsgroup.ch, Tel.: +41 79 702 00 40